기술사 제 87 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	7.4	자격	ᄑᄜᆌᆁᆁᄉᄱ	수험	성	
야	古等	종목	표먼서디기물사	번호	팡	

※ 다음 문제 중 10 문제를 선택하여 설명하시오. (각 10 점)

- 1. 강을 침탄법으로 표면경화 시킬 때 일반적으로 침탄 처리온도를 강의 Ac3 또는 Ac1 변태온도 이상에서 처리하는 이유를 설명하시오.
- 2. 스크린인쇄법(Screen printing)에 대하여 설명하시오.
- 3. Al 양극산화의 한 공정인 봉공처리(sealing)에 대하여 설명하시오.
- 4. 금속재료의 전기화학적 수소과전압(Hydrogen overvoltage)에 대한 정의와 수소과전압의 변화조건을 금속의 부식에 관련시켜 설명하고, 수소과전압이 큰 경향의 금속과 작은 경향의 금속을 각각 2 개씩 쓰시오.
- 5. 산용액에서 철의 전기화학적 부동태 현상에 대한 일반적인 전위-전류의 그림을 작성하고, 이를 설명하시오.
- 6. 다음 전극반응의 표준환원전극전위를 보고 Pb와 Fe중 어느 쪽 금속이 안정된 금속인지를 쓰고, 그 이유를 설명하시오.

전극반응	표준환원전극전위 (V)
Pb ²⁺ + 2 e = Pb	-0.126
Fe ²⁺ + 2 e = Fe	-0.440

- 7. 진공증착과 Ion Plating 의 장.단점에 대해 설명하시오.
- 8. 아크용사법의 원리와 장.단점에 대해 설명하시오.
- 9. 무전해도금에 사용되는 환원제의 원리를 설명하고, activation 처리가 필요한 이유를 설명하시오.

2 - 1

기술사 제 87 회

제 1 교시 (시험시간: 100분)

분	7.4	자격	ᄑᄜᅴᆌᆁᄉᆡ	수험	성	
야	古名	종목	표먼저디기술사	번호	명	

- 10. 응력부식균열의 발생원리와 진행과정을 설명하시오
- 11. 도금된 제품의 내식성을 시험하는 방법 중 하나인 염수분무시험을 통해 얻은 결과에 대해 내식성을 판정하는 기준을 상세히 설명하시오.
- 12. 물리적 기상증착법(Physical vapour deposition) 중 스팟터링(Sputtering)에 대한 원리 및 특징을 각각 설명하시오.
- 13. 철판을 방식하기 위한 아연도금과 주석도금을 각각 설명하고, 그 차이점을 설명하시오.

기술사 제 87 회 제 2 교시 (시험시간: 100 분)

분		자격	ㅠ머ㅋㅋㅋ스시	수험	성	
야	古名	종목	표면서디기물 사	번호	명	

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

- 1. 자동차 외판의 하지도장으로 사용하는 인산염아연 화성처리에 대하여 설명하시오.
- 2. 연성 인쇄회로기판(Flexible printed circuit board)의 기판인 연성 동피복 기판(Flexible copper clad laminate)의 스루홀(Through hole) 내벽에 동피복을 얻기 위한 2 가지 방법을 쓰고, 이에 대해 설명하시오.
- 3. 진공장비의 진공누설을 측정하는 방법 3 가지를 쓰고 설명하시오.
- 4. 분극(polarization)의 개념을 설명하고 분극곡선을 얻는 방법에 대해 설명하고 이를 활용하는 예를 2 가지만 쓰시오.
- 5. SiO2 산화물을 금속 기판위에 코팅하기 위해 Sol-Gel 법을 이용하고 있다. Sol-Gel 법에 의한 코팅과정에 대해 순서적으로 기술하시오.
- 6. 전해연마(Electro polishing)와 화학연마(Chemical polishing)에 대한 정의와 특징을 설명하고, 전위-전류곡선(아래 그림)에서 각 구간별 일어나는 현상을 설명하시오.

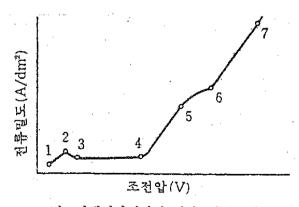


그림. 전해연마에서의 전압-전류곡선

기술사 제 87 회 제 3 교시 (시험시간: 100 분)

분	7.4	자격	ㅠ머티기기스시	수험	성	
야	古名	종목	표면서디기물 사	번호	명	

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

1. Sn⁺⁺가 용해된 25°C의 도금조에서 8 분간 구리판에 주석 도금을 하였더니, 도금판의 질량이 11g 증가하였다. 구리 전기량계의 음극 중량 증가가 6g 이었다면, 몇 A의 전류가 흘렀으며, 이 때 도금의 전류효율은 얼마인지 구하시오.

(단, 주석의 원자량은 119 이며, 구리의 원자량은 63.5, 1 F=96,485 C)

- 2. 전기도금시에 발생하는 수소취성(Hydrogen Embrittlement)이란 무엇이며, 이에 따른 발생원인과 방지법에 대하여 쓰시오.
- 3. 도금공장에서 발생되는 폐수의 종류 및 그 특성과 폐수처리법에 대하여 설명하시오.
- 4. 오스테나이트(Austenite)계 스테인레스강의 용접열화(Weld decay) 현상 및 그 방지법을 설명하시오.
- 5. 무전해 Ni-P 도금의 생성원리 및 도금시 사용하는 성분 각각의 역할에 대하여 설명하시오.
- 6. 아연(Zn) 도금을 한 후 처리하는 크로메이트(Chromate) 처리의 생성원리를 설명하시오.

기술사 제 87 회 제 4 교시 (시험시간: 100 분)

					<u> </u>		
분	7 4	자격	ᄑᄜᆌᆌᆁᄼᆁ	수험		성	
야	古名	종목	#먼저디기술 사	번호		명	

※ 다음 문제 중 4 문제를 선택하여 설명하시오. (각 25 점)

- 1. 박막의 성분분석법 중의 하나인 XPS(X-ray photoelectron spectroscopy)와 AES(Auger electron spectroscopy)법에 대하여 설명하시오.
- 2. WEEE 와 RoHS 등에 근거하여 친환경적인 솔더링(soldering) 접합공정 사용을 위한 규제를 시작하고 납을 함유하는 전기.전자 제품은 판매가 금지되어 무연화 솔더 도금을 하지 않으면 안 된다. 무연화 솔더 도금의 특성과 합금 도금욕 대하여 설명하시오.
- 3. PL(Photo-Luminescence)과 EL(Electro-Luminescence) 소자의 발광원리 차이점에 대해 서로 비교하여 설명하시오.
- 4. R.F.Sputtering을 이용하여 산화물 같은 비금속을 금속 표면 위에 코팅할 수 있는 원리에 대해 간단히 설명하고, Cu 기판위에 Al2O3를 코팅하고자할 때 사용할 수 있는 그 밖의 방법에 대하여도 2 가지를 설명하시오.
- 5. 니켈을 황산욕에서 전기도금 하는 경우에 발생하는 양극의 부동태화를 설명하고, 니켈도금에서 양극의 부동태화를 예방하는 방법을 설명하시오.
- 6. 마그네슘(Mg)의 표면처리 방법에 대하여 설명하시오.